

多層薄膜フィルムの半抜加工

月産数量（研究/試作/実生産）：30 万枚（実生産）

部品・加工法の特徴

50 μ m の基材となるフィルムに 25 μ m の保護フィルムを 5 μ m の厚みの接着層で接合した素材（図 1）を、切断刃を使用して 50 μ m の基材フィルムだけ切断し、5 μ m の接着層領域で刃先を止め、25 μ m の保護フィルムに傷をつけずに加工する技術である。

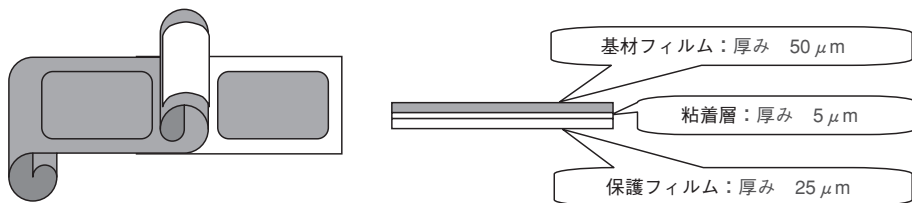


図 1 粘着材付多層樹脂フィルムの構造

使用機械

型式：ZEN Former nano MPS 405-UD

（写真 1）

加圧能力：50 kN

加工形態：順送加工（自動材料供給、
巻取り装置付）

写真 1
「ZEN Former nano
MPS 405-UD」外観



使用加工モーション設定

標準設定：V 字モーション

オリジナル設定：スライド平行制御